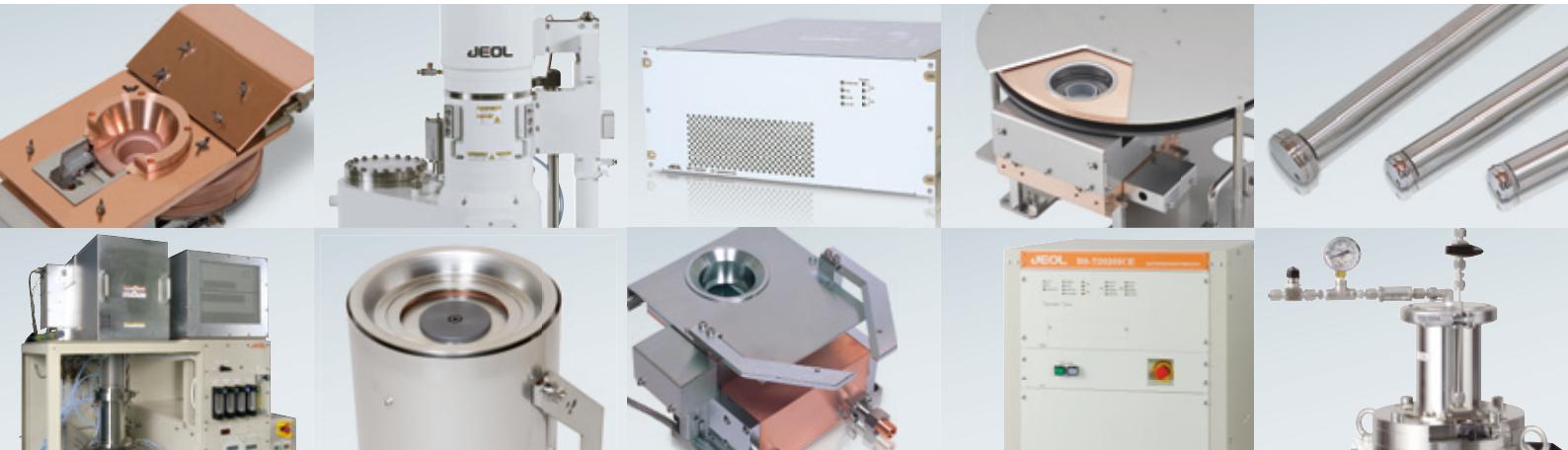


Solutions for Innovation

Industrial Equipment General Catalog

Electron Beam Source / High-power Electron Beam Source /
Plasma Source / RF Generator / RF Induction Plasma System /
Fine Powder Feeder / Rotary Sensor



Electron Beam Source

電子銃（偏向型）

真空蒸着用の電子銃です。金属・酸化物を問わず、様々な無機材料を電子ビーム加熱により蒸発させ薄膜を形成することができます。

Electron beam sources for vacuum evaporation of metal and metal-oxide thin-films. We offer a wide variety of electron beam sources and crucibles.

特長

日本電子製電子銃は、ビーム入射角度、ビームスポット径、エネルギー密度、高速スキャニング性能に優れています。高融点で熱伝導の低い材料や酸化物などの昇華性材料の蒸着も容易であり、再現性のある均一な膜厚分布が得られます。

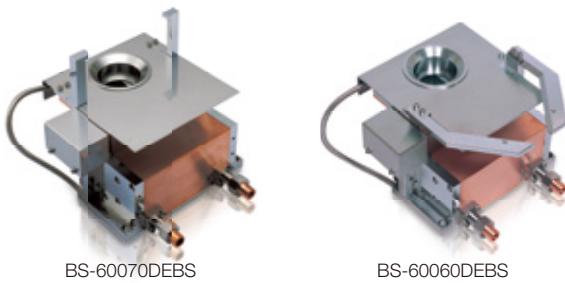
Features

JEOL electron beam sources have excellent properties in terms of beam incident angle, beam spot shape, energy density and high-speed sweeping. Thus, can attain excellent melted remain of evaporation materials and good for film thickness uniformity and reproducibility.

Model	Maximum Output	Beam Deflection	Crucible	Filament	Main use
BS-60070DEBS	6.4 kW	270°	Unequipped ^{※2}		
BS-60060DEBS	6.4 kW	270°	Unequipped ^{※2}		
BS-60050EBS	10 kW	270°	Unequipped ^{※2}		
BS-60040VDGN	10 kW	270°	Unequipped ^{※2}		
BS-60030DGN	10 kW	270°	Unequipped ^{※2}		
JEBG-102UH0	10 kW	180°	Unequipped ^{※2}		
EBG-102UB6S	10 kW	180°	6×12 mL		
EBG-102UB4S	10 kW	180°	4×12 mL		
BS-60250DEM	16 kW	270°	Unequipped ^{※2}		
BS-60211DEM w/BS-60141H4M	10 kW	270°	4×40 mL		
BS-60211DEM w/BS-60151H6M	10 kW	270°	6×40 mL		
JEBG-203UA0	20 kW ^{※1}	270°	Unequipped ^{※2}		
EBG-203UB6S	20 kW ^{※1}	270°	6×12 mL		
EBG-203UB4H	20 kW ^{※1}	270°	2×12 mL 2×28 mL		
JEBG-303UA	30 kW ^{※1}	270°	Option		

※1: Maximum power is limited by the power supply.

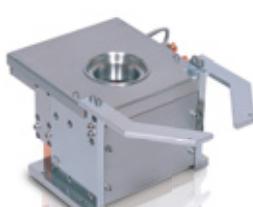
※2: Custom-built crucibles are acceptable.



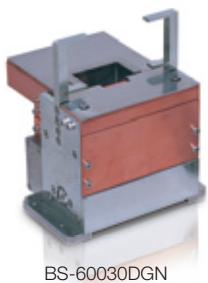
BS-60070DEBS



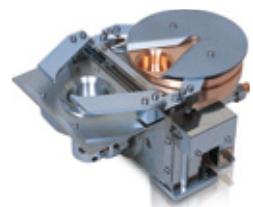
BS-60060DEBS



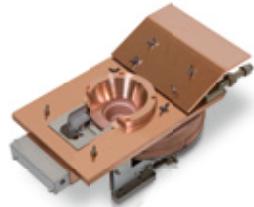
BS-60050EBS



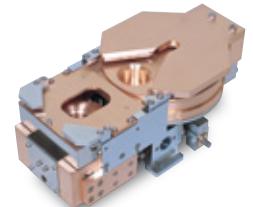
BS-60030DGN



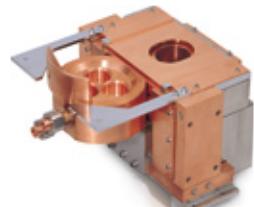
EBG-102UB6S



BS-60211DEM w/BS-60141H4M



EBG-203UB6S



JEBG-303UA w/EBG-30T3B



BS-60250DEM



ボンバード蒸着源

電子ビームボンバード間接加熱法を利用した真空蒸着源です。

低ダメージ、低欠陥、低吸収、成膜に適しています。

BS-60610BDS ではライナー大容量化とハイレート化を実現しています。

Vacuum evaporation source using the indirect heating method of electron beam bombardment. Suitable for deposition of low damage, low defect, low absorption and high rate. BS-60610BDS achieves higher liner capacity and higher deposition rate.

Model	Specification
BS-60610BDS	4.8 kW / 6 liner / High deposition rate type
BS-60310BDS	1.2 kW / 6 liner

* Bombardment Deposition Sources with different number of liners can also be produced.

ボンバード方式による加熱原理（イメージ図）



High-power Electron Beam Source

高出力電子銃（直進型）

真空中で金属や酸化物を蒸着または溶解するための高出力の電子ビーム源です。連続的に走行する幅広の長尺フィルムや大面積のガラス基板上へハイレートで成膜します。また電子ビーム溶解用として、高融点金属のインゴット作製・精錬に使用されます。

High-power electron beam sources for vacuum evaporation of metals and metal-oxides to a wide plastic film or a large glass plate that are continuously fed. And also used for vacuum melting of high-melting point metals.

特長

電子ビームは広範囲に高速で走査することができます。専用の制御装置とソフトウェアにより、様々なビーム照射パターンやエリアを作成できます。各照射位置においてスキャン、滞在時間、出力、ビーム形状を設定できるため、溶融面や膜厚分布の制御が可能です。

Features

Electron beam can be swept a wide area at high speed. Various beam irradiation patterns and areas can be created by the dedicated control device and the software.

Sweeping, dwell time, output power and beam shape at each irradiation position can be set up individually, thus can control the melting surface and the film thickness distribution.

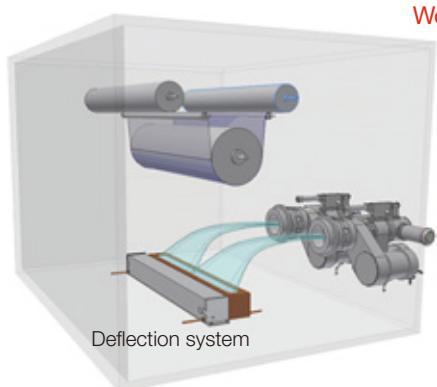
用途

- 真空蒸着
バリア膜、保護膜、電極膜、導電膜、磁性膜 等の薄膜形成
- 真空溶解
Ti, Ta, Nb, Mo 等高融点金属のインゴット作製・精錬、多結晶シリコン精錬

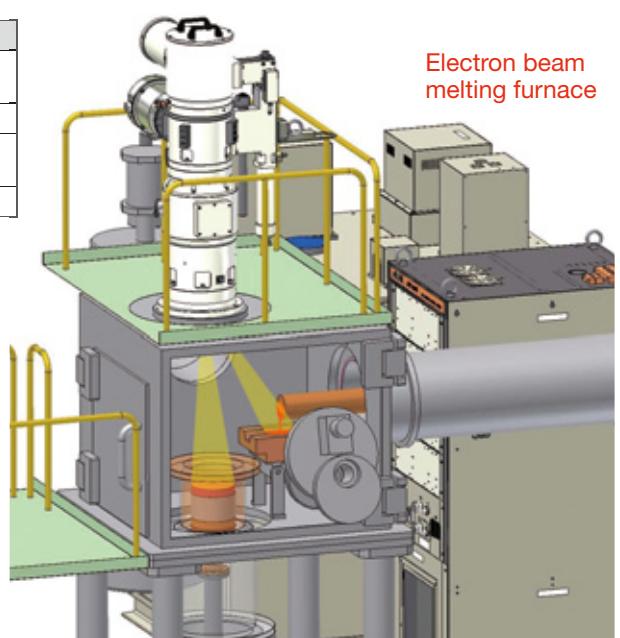
Applications

- Vacuum deposition
Gas barrier films, protective films, electrode films, conductive films, magnetic storage films.
- Vacuum melting
Refinement / Ingot production of high-melting-point metals such as Ti, Ta, Nb and Mo.
Polycrystalline silicon refining for solar cell.

	EBG-300UA	JEBG-1000UB	JEBG-3000UB
Maximum output	30 kW (20 kV, 1.5 A)	100 kW (30 kV, 3.4 A)	300 kW (40 kV, 7.5 A)
Beam sweeping range	Max ±30°, X and Y axis		
Maximum sweeping frequency	300 Hz	200 Hz	200 Hz (300 Hz: Option)
Power supply model	ST-30BE2	JST-100C	JST-300CHR



真空蒸着 / Vacuum deposition



Plasma Source

プラズマ銃

真空チャンバー内に設置し、高密度なプラズマを発生させるプラズマ源です。真空蒸着と組み合わせたプラズマアシスト蒸着（イオンプレーティング）により、光学薄膜や透明導電膜、保護膜などの膜質や膜特性を向上させる事ができます。また基板／基材の表面改質やクリーニングにも適用できます。BS-80011BPGは6 kWの高出力タイプで、Φ2,000 mmチャンバーまでの大容量空間へ高密度プラズマを発生することができ、大面積へ高速蒸着ができます。BS-80020CPPSは、プラズマによる基板温度上昇を抑え、基板へのイオン照射エネルギーを高めた低温プロセス用のプラズマソースです。

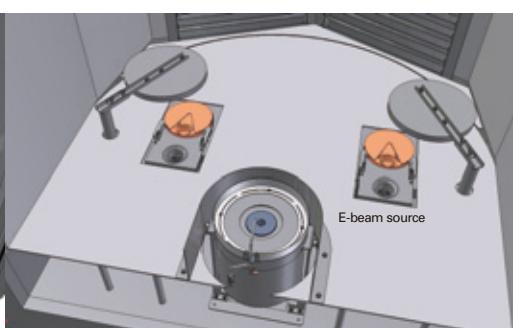
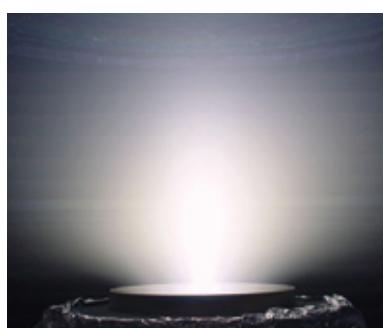
Plasma Source is installed in a vacuum chamber and generates high-density plasma. Used as Plasma Assisted Deposition (Ion Plating) and possible to improve film quality and properties of optical thin films, transparent conductive films and protective films. And also used for cleaning and surface modification of a substrate/film. BS-80011BPG is a high-power type that can generate high-density plasma in a mass space, for example up to Φ2,000 mm chamber, thus high-rate deposition to a large area is possible. BS-80020CPPS is designed for low-temperature process, such as for a plastic substrate/film.

効果

- ・膜密度や屈折率の向上
- ・耐環境性の向上
- ・波長シフトの低減
- ・低吸収膜（酸化促進）
- ・密着性の向上
- ・表面平滑性の向上
- ・膜応力の制御

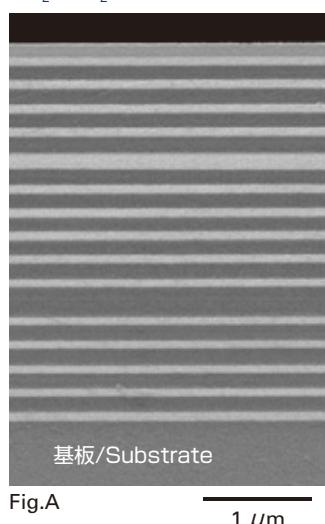
Effect

- Improvement of film density, refractive index
- Production of environmentally stable films
- Low wavelength shift
- Low optical absorption (promotion of film oxidation)
- Improvement of film adhesion
- Improvement of surface roughness
- Control of film stress



TiO₂/SiO₂光学多層膜を、1,300 mm径の真空蒸着装置内で BS-80011BPGを使用して成膜

TiO₂/SiO₂ multi-layer optical thin film was deposited using the BS-80011BPG in a 1,300 mm diameter vacuum deposition system.



—：成膜後24時間
—：300 ℃加熱10分
—：煮沸6時間
—：24h after deposition
—：10 min heating at 300 °C (572°F)
—：6h boiling

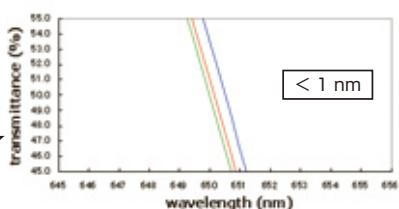
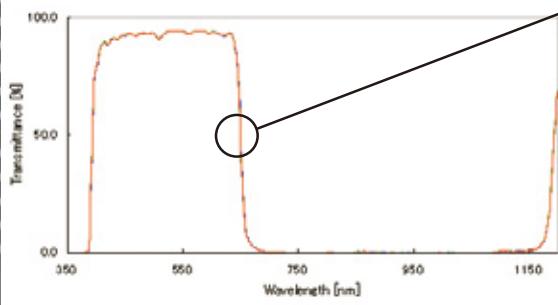


Fig.A TiO₂/SiO₂多層膜断面のSEM像
Fig.B 環境テストを施した後の、T=50%での波長シフト

Fig.A Cross-section SEM images of TiO₂/SiO₂ multilayer.
Fig.B Wavelength shift at T=50% after environmental tests.

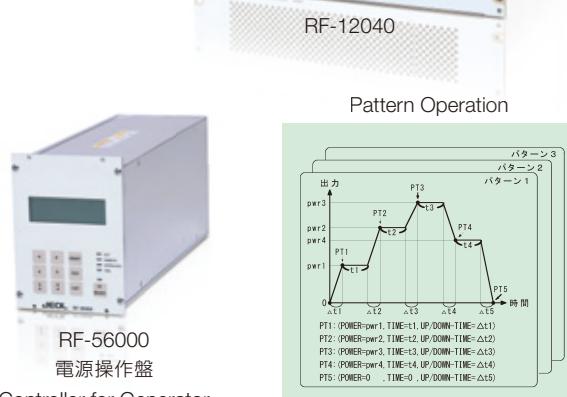
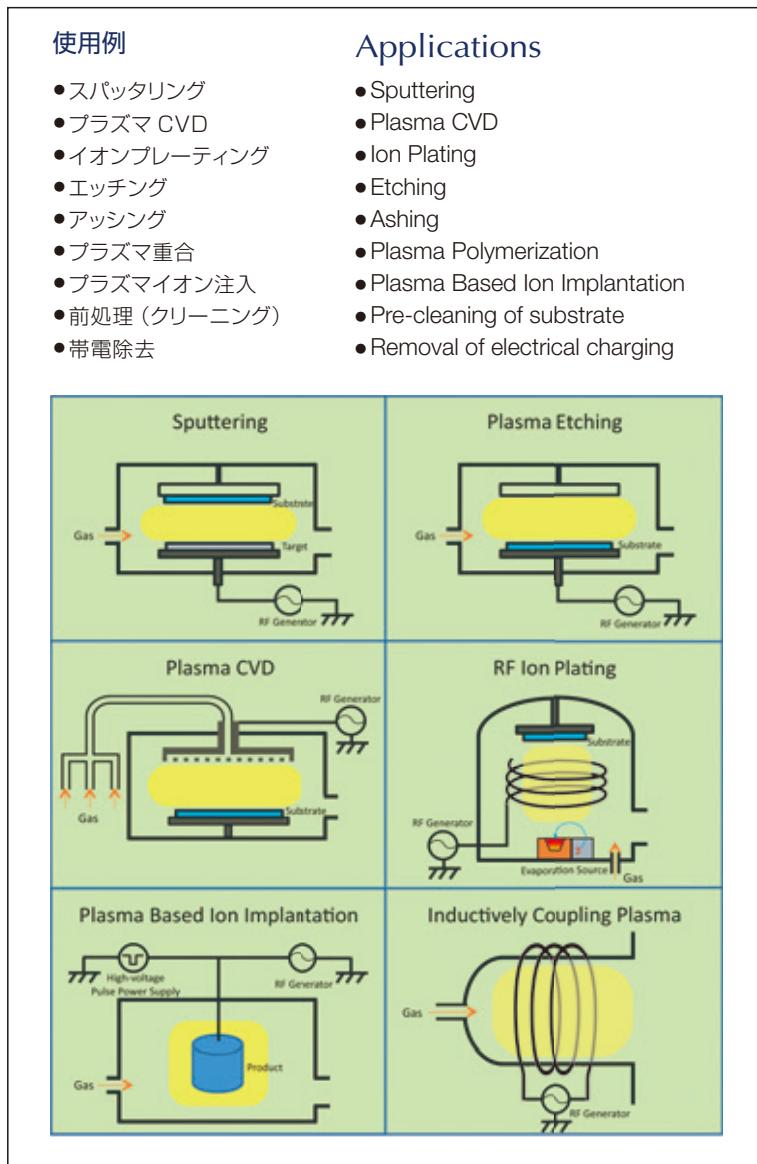
RF Generator

高周波電源

プラズマを利用してスパッタリングやエッチング、CVD、イオンプレーティングなど薄膜形成 / 加工用に使用される13.56 MHzのプラズマ発生用高周波電源です。RF-120シリーズはDeviceNet、RS232C、アナログの各インターフェイスを標準装備し、パターン運転、アーカカット / 回数制限やパルス運転（オプション）などの機能を有する多機能電源です。各出力に対応した自動整合装置もラインナップしています。

RF-120 series are 13.56 MHz radio-frequency power supplies for plasma application such as sputtering, CVD, etching and ion-plating. This series are equipped with interfaces of DeviceNet, RS232C, analog and have various functions of pattern operation, arc handling, pulse operation (optional). We also offer various types of auto matching networks.

最大出力 Max. output	高周波電源 RF Generator	自動整合装置 Auto Matching Network
750 W	RF-12010	
1.5 kW	RF-12020	RF-34021
3 kW	RF-12030	RF-34031
6 kW	RF-12040	RF-34041



Controller for Generator

RF-56000
電源操作盤

Controller

Matching Box



RF-34021

自動整合装置 / Auto Matching Network



EH-HVW30G03
水冷導入端子(アンテナ放電用)
Water-cooled feed-through for antenna discharge

RF Induction Plasma System

高周波誘導熱プラズマ装置

高周波誘導熱プラズマは、大気圧もしくは大気圧に近い減圧雰囲気下において、高周波電力を局的に集中させ、電磁誘導により様々なガスを瞬時に約1万度もの超高温プラズマ状態に変えます。この熱プラズマ中に微粉末などの原料を投入し、蒸発や溶融、化学反応を行います。これによりナノ粒子の合成や改質、複合粒子や球状粒子の作製、厚膜／複合膜の合成、有害ガスの分解などを行うことができます。

Thermal plasma around 10,000 °C (18,000°F) generated by radio-frequency inductive coupling under atmospheric or reduced pressure.

This induction plasma is used for nano powder synthesis or reforming, fine powder spheroidization, thick-film deposition, multi-composite membrane synthesis, CVD and harmful gas decomposition.

特長

- 超高温のため、沸点の異なる異種原料でも、瞬間にその場でフラッシュ蒸発させることができます。
- プラズマは空中に浮いている状態なので、高純度の材料合成が可能です。
- また、無電極放電のため、電極物質がプラズマ中に不純物として混入せず、原料成分のまま蒸発または溶融することができます。
- 様々なガスをプラズマ化することができ、高ラジカルの反応場で、酸化／還元／窒化／炭化などの化学反応や改質が可能です。
- プラズマの超高温領域を通過後は急激に冷却されます。
(超急冷プロセスにおける核生成・凝縮)
- 直流熱プラズマと比較して大きなプラズマフレームが得られます。
さらにプラズマの流速は直流熱プラズマと比較して一桁遅いため、原料を十分に加熱・反応させることができます。
- 直流プラズマを高周波プラズマに重畠させ、より加熱効率が優れるハイブリッド方式もご提案できます。

Features

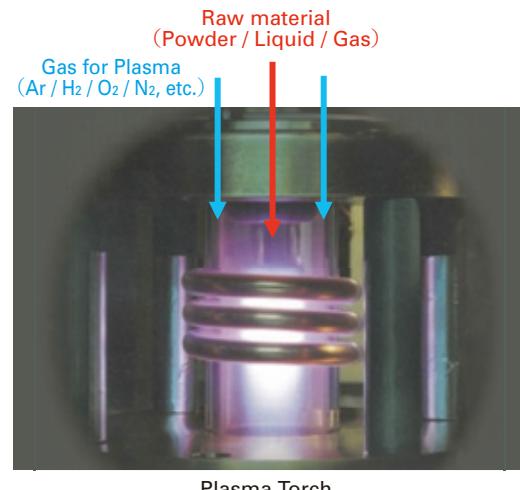
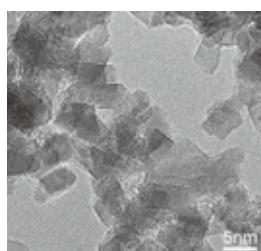
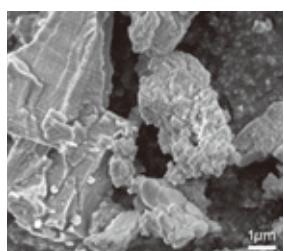
- The ultra-high temperature field enables instantaneous in-situ flash vaporization even for several different materials with different melting points.
- Since there is no consumable electrode, the material can be vaporized or fused as is. This is a contamination-free, high-purity environment.
- Plasmas can be generated with various types of gases, enabling reforming and chemical reactions like oxidation, reduction, nitriding, carbonization and chlorination
- Rapid cooling after passing through the ultrahigh temperature region of the plasma.
(Nucleation / condensation with a rapid quenching process)
- In comparison to DC thermal plasma, a large plasma flame can be obtained. In addition, the plasma flow rate is an order of magnitude slower than that of DC thermal plasma, making it possible to heat and react chemically the materials sufficiently.
- We also offer unique hybrid plasma technologies.(DC+RF)

Product lineup

6 kW / 100 kW × RF / Hybrid × System / Component (Plasma Source)

Example of nano particle synthesis

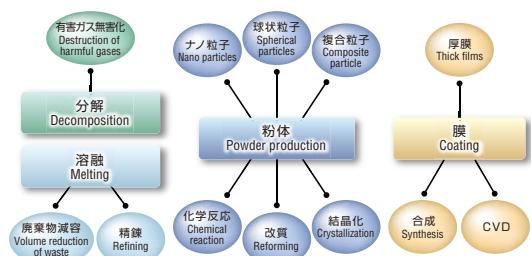
Mixed ceramics



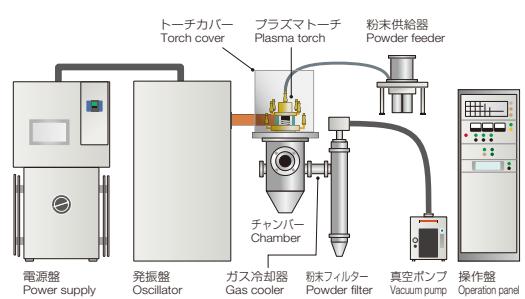
Plasma Torch



TP-40020NPS (6 kW)



用途例 (Application examples)



システム構成例 (System Configuration)

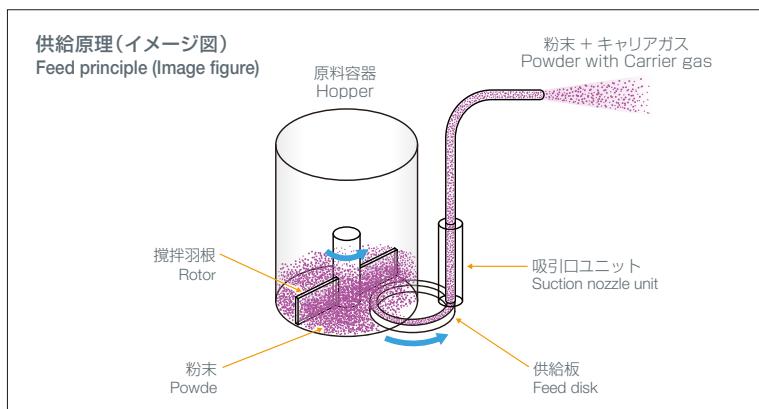
Fine Powder Feeder

粉末供給装置

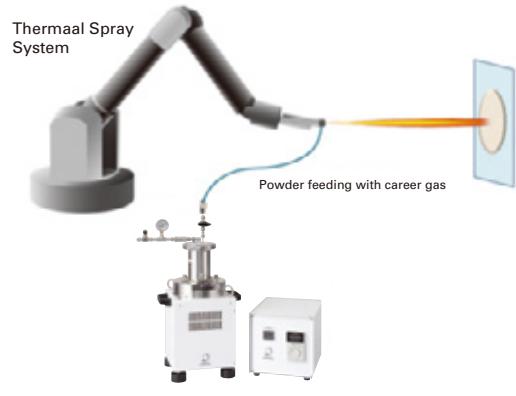
微粒子をキャリアガスと共に配管を通して搬送するための粉末供給装置です。
今まで困難であった1～数 μm の微粒子も安定に供給することができます。

Fine powder feeder that can feed continuously through a tube with carrier gas.
One to a few micrometers powder which was difficult to feed can be stably supplied.

	テーブル式 Rotary table type
粉末粒径 Powder size	approx. 0.1 to 100 μm or more
粉末供給率 Feeding rate	approx. 1 to 100 g/min or more
キャリアガス種 Carrier gas species	アルゴン、窒素、空気 Argon, Nitrogen, Air
キャリアガス流量 Gas flow volume	approx. 2 to 20 L/min



TP-99140FDR テーブル式粉末供給装置



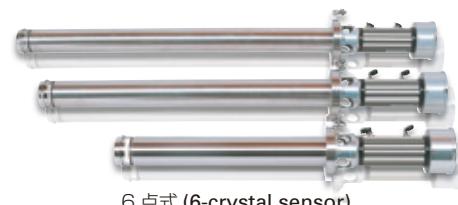
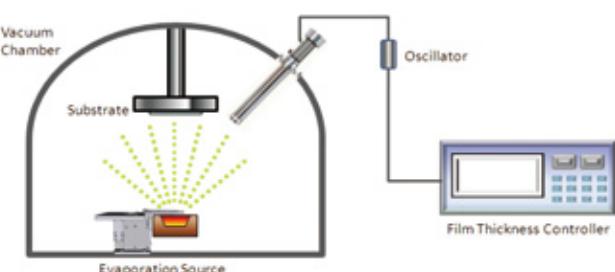
溶射イメージ図

Rotary Sensor

ロータリーセンサー

水晶振動子膜厚コントローラー / モニターに接続して、真空蒸着時の膜厚や蒸着レートを測定 / 制御するための多点センサーです。水晶振動子 (クリスタル) が6枚ないし12枚装着されており、クリスタルが寿命 (Crystal Fail) になると次のクリスタルへ切り替えてそのまま使用できるため、厚膜や多層膜の成膜に適しています。検出孔が定位置なので、クリスタルが移動ごとに Tooling Factor 値を変える必要はありません。

Rotary Sensor is used with a thin film deposition controller/monitor that monitor or control the film thickness and deposition rate in a vacuum deposition process. Incorporates 6 or 12 quartz crystals, therefore suitable for thick films or multiple layers.



6点式 (6-crystal sensor)



12点式 (12-crystal sensor)



Sensor Head (Flat type)

Sensor Head (45° type)

